Особенности реализации полупроводниковых датчиков температуры

Олег Дворников, Владимир Чеховский, Валентин Дятлов (г. Минск, Беларусь), Николай Прокопенко (г. Шахты, Ростовская обл.)

В статье рассмотрены температурные зависимости вольтамперных характеристик элементов биполярных микросхем, проанализированы схемотехника и параметры полупроводниковых датчиков температуры серий LM, MCP, TMP и ADT. Особое внимание уделено повышению точности измерения.

Введение

Датчик температуры – один из наиболее распространённых первичных измерительных преобразователей. Это объясняется как потребностью в высокоточной регистрации температуры для многих областей науки и техники, так и необходимостью осуществления компенсации температурного изменения основных характеристик в различных микроэлектронных устройствах [1].

Различие диапазона регистрируемых температур и требований к согласованию с микроконтроллерами обуславливают существование разнообразных термочувствительных элементов и их интерфейсов. Так, в качестве термочувствительных элементов чаще всего применяют термопары (Thermocouple), резистивные температурные датчики (Resistive Temperature Detector), термисторы (Thermistor), полупроводниковые активные и пассивные элементы, а выходной информацией температурных датчиков может быть [2, 3]:

- напряжение или ток, пропорциональные температуре (Analog Output);
- частота, пропорциональная температуре (Frequency Output);
- скорость изменения выходного сигнала, пропорциональная температуре (Ramp Rate Output);
- коэффициент заполнения выходного сигнала, пропорциональный температуре (Duty Cycle Output);
- цифровые данные (Serial Output), передаваемые по разным шинам, например, SPI, I²C, SMBus;
- логический уровень, показывающий превышение заданной температуры или нахождение в заданном диапазоне температур (Logic Output). Целью настоящей статьи является аналитический обзор датчиков тем-

пературы, допускающих как отдельное применение, так и использование в составе микроэлектронных интерфейсов [1, 4]. В большинстве случаев такие датчики должны работать в диапазоне температур –60...+125°С, обеспечивать аналоговый выход и технологическую совместимость с интегральными схемами (ИС) интерфейсов.

Температурные зависимости параметров основных элементов ИС

Температурные зависимости параметров элементов ИС были исследованы при проектировании источников опорного напряжения [5]. Некоторые из этих зависимостей, например, падение напряжения на прямосмещённом *р-п*-переходе, являются основой построения термочувствительных элементов, а другие, такие как температурная зависимость сопротивления полупроводниковых резисторов и обратного тока насыщения *р-п*-перехода, приводят к нелинейности преобразования температуры в амплитуду выходного сигнала датчика. Таким образом, при проектировании датчиков температуры необходимо представлять температурные зависимости элементов и правильно учитывать их при схемотехническом моделировании, а также рассматривать возможность компенсации нелинейных температурных эффектов.

Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы (БТ) используются в различных цепях ИС для усиления напряжения и тока, формирования источников и повторителей тока, сдвига уровня постоянного напряжения, в качестве термочувствительных элементов и пр. В зависимости от области применения, к параметрам БТ предъявляются различные требования, которые будут рассмотрены ниже.

Основную температурную зависимость кремниевых БТ описывают выражения [6]:

$$I_{\rm C} \approx IS \times \exp \frac{V_{\rm BE}}{\phi_{\rm T}},$$
 (1)

$$IS = \text{const} \times T^n \times \exp{-\frac{E_{G0}}{\phi_{T}}}, \qquad (2)$$

где I_c - коллекторный ток; IS - обратный ток насыщения эмиттерного перехода; V_{вг} – падение напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе; $\phi_T = k \times T/q$ – температурный потенциал; k – постоянная Больцмана; T – температура в градусах Кельвина; q – заряд электрона; const - постоянная, определяемая физико-технологическими параметрами БТ, не зависящая от температуры и прямо пропорциональная площади эмиттерного перехода $S_{\rm F}; n$ – показатель степени, описывающий, в том числе, температурную зависимость подвижности неосновных носителей заряда, п изменяется от 1,5 до 3 [6]; E_{G0} – ширина запрещённой зоны кремния при T = 0 К.

При работе БТ в широком диапазоне коллекторных токов необходимо учитывать отклонение вольтамперной характеристики (BAX) от экспоненциальной зависимости (1), которое обычно описывается с помощью зависящего от коллекторного тока *m*-фактора:

$$I_{\rm C} \approx IS \times \exp \frac{V_{\rm BE}}{m \times \phi_{\rm T}} =$$
$$= \operatorname{const} \times T^n \times \exp \frac{\frac{V_{\rm BE}}{m} - E_{\rm G0}}{\phi_{\rm T}}.$$
(3)

Чаще всего величина *m*-фактора находится в диапазоне от 1 до 3. В области малых токов отклонение *m* от единицы объясняется усилением влияния на работу БТ процессов рекомбинации, а в области больших токов – сопротивлением базовой области и эффектами высокого уровня инжекции, поэтому значение *m*-фактора частично зависит от конструкции транзистора. Так, для горизонтальных *p*-*n*-*p*-транзисторов отклонение *m* от единицы в области малых коллекторных токов обычно проявляется раньше, чем для *n-p-n-*транзисторов из-за увеличения рекомбинационных токов. Уменьшить величину *m*-фактора в области больших коллекторных токов возможно с помощью конструкций БТ, обеспечивающих малое сопротивление базовой области.

На ВАХ транзисторов также влияют механические напряжения, возникающие на кристалле из-за действия различных температурных коэффициентов расширения материалов подложки и корпуса или при герметизации кристалла с помощью полимеров [7]. Эти напряжения являются одной из причин долговременного дрейфа характеристик. Экспериментальные исследования показали, что изменение характеристик вертикальных *р-п-р*-транзисторов с коллектором на подложке при наличии механических напряжений меньше, чем п-р-п-транзисторов [8].

Таким образом, при выборе БТ для датчиков температуры можно рекомендовать:

- в качестве термочувствительного элемента – прямосмещённый эмиттерный переход вертикального *p-n-p*или *n-p-n*-транзистора (не допускается использование горизонтального *p-n-p*-транзистора);
- конструкцию БТ с минимальным сопротивлением базовой области;
- максимальное увеличение плотности коллекторного тока до появления области, в которой *m* > 1.

Последнее условие легко выполнить при схемотехническом моделировании БТ, включённого по схеме с общей базой, и расчёте *m*-фактора по соотношению:

$$m = \frac{V_{\rm BE}}{\phi_{\rm T} \times \ln \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm CM1}} + V_{\rm BEM1}}, \qquad (4)$$

где V_{BEM1} – падение напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе при величине коллекторного тока I_{CM1} , соответствующей среднему уровню токов, где $m \approx 1$.

Пример моделирования и расчёта *m*-фактора, позволяющий выбрать область рабочих токов и напряжений, приведён на рисунках 1 и 2 для *n-p-n*транзистора базового матричного кристалла «АБМК-1.3» [5]. В соответствии с правилами графического постпроцессора системы проектирования OrCAD на вертикальной оси отображена переменная *V(Vb:+)/(714.29mV+* + 26*mV**LOG(I(*Q*1:c)/50.63*u*A)), которая соответствует (4) при V_{BEM1} = 714,29 мВ, I_{CM1} = 50,63 мкА, ϕ_T = 26 мВ.

Важность учёта *m*-фактора при выборе БТ в качестве термочувствительного элемента неоднократно отмечалась в литературе [9, 10]. Поэтому для обеспечения высокой точности температурных измерений с помощью дискретных транзисторов можно рекомендовать выполнение измерений и отбор транзисторов по *m*-фактору в соответствии с (4), например, с применением измерителя параметров полупроводниковых приборов ИППП-1 и графического постпроцессора OrCAD [11, 12].

Из (3) получаем соотношения для определения прямого падения напряжения на эмиттерном переходе БТ $V_{\text{BE}} = f(I_{\text{C}}, T)$ и его температурного изменения $dV_{\text{BE}}/dT = f(I_{\text{C}}, T)$:

$$\frac{V_{\rm BE}}{m} = E_{\rm G0} \times \left(1 - \frac{T}{T_0}\right) + \frac{V_{\rm BE0}}{m} \times \frac{T}{T_0} + \frac{m \times k \times T}{q} \times \ln \frac{T_0}{T} + \frac{k \times T}{q} \times \ln \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm C0}},$$

$$\frac{1}{m} \times \frac{dV_{\rm BE}}{dT} = -\frac{E_{\rm G0} - \frac{V_{\rm BE0}}{m}}{T_0} - \frac{m \times k}{q} \times \left(1 + \ln \frac{T}{T_0}\right) + \frac{k}{q} \times \ln \frac{I_{\rm C}}{I_{\rm C0}},$$
(6)

где V_{BEO} – падение напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе в опорной рабочей точке при $T = T_0$, $I_C = I_{CO}$.

Заметим, что для транзистора типа GC1E n = 1,23 в диапазоне температур от 200 до 400 К и $I_{C0} = 400$ мкА, поэтому в соответствии с (6) температурный коэффициент dV_{BE}/dT при T = 300 К будет составлять -1,744 мВ/К.

Характеристики ряда аналоговых устройств, выполненных на БТ, зависят от статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером (β) и его температурной зависимости, для оценки которой справедливо условие [13]:

$$\frac{\mathrm{d}\beta}{\beta} \times \frac{1}{\mathrm{d}T} = +0,005 \left[\frac{1}{^{\circ}\mathrm{C}}\right]. \tag{7}$$

В Spice-подобных симуляторах температурную зависимость $\beta = \beta(T)$ характеризуют главным образом параметром *XTB*:

$$BF(T) = BF(T_0) \times \left(\frac{T}{T_0}\right)^{XTB}, \quad (8)$$

где BF(T), $BF(T_0)$ – величина Spiceпараметра *BF* при температуре *T*, *T*₀;



Рис. 1. Зависимость коллекторного тока (график 1, ось 1) и *m*-фактора (график 2, ось 2) от напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе *n-p-n*-транзистора типа GC1E



Рис. 2. Зависимость *m*-фактора от коллекторного тока *n-p-n*-транзистора типа GC1E

 $BF - \beta$ в активном режиме работы БТ в прямом включении в том случае, когда допустимо пренебречь зависимостью β от тока и напряжения на коллекторном переходе, *XTB* – температурный коэффициент параметра *BF*.

Обычно за величину параметра *BF* принимают максимум функции [14]:

$$\beta = \beta(I_C)$$
 при $V_{CB} = 0,$ (9)

поэтому величину *XTB* необходимо подобрать таким образом, чтобы при крайних значениях диапазона температур для максимального β обеспечивалось выполнение условия (8). Например, максимальная величина β при температуре –60°С составляла 54,18%, а при+125°С – 134,68%, значения при нормальных же условиях (27°С) – 89,21%, как показано на рисунке 3 для транзисторов «АБМК-1.3».



Рис. 3. Температурная зависимость β биполярных транзисторов «АБМК-1.3»:

а – *п-р-п*-типа 2GC; б – *р-п-р*-типа PNPJFpnp



Рис. 4. Температурный коэффициент сопротивления кремниевых резисторов разного типа проводимости в зависимости от концентрации примеси при температурах 300–450 К (а) и 200–300 К (б)



Рис. 5. Зависимость коэффициента VC1 от напряжения:

- 1 для *p*-резистора: *L* = 7,5 мкм, *W* =10 мкм;
- 2 для *p*-резистора: *L* = 9,0 мкм, *W* = 10 мкм;
- 3 для ПКК-резистора: L = 192 мкм, W = 20 мкм

Резисторы

Зависимость сопротивления резистора от напряжения и температуры *R(V, T)* при моделировании часто представляют в следующем виде:



Рис. 6. Зависимость коэффициента *TC*1 от температуры:

1 – для *р*-резистора: *L* = 7,5 мкм, *W* = 4 мкм; 2 – для ПКК-резистора: *L* = 192 мкм, *W* = 20 мкм

 $R(V, T) = R_0 \times [1 + VC1 \times (V^+ - V^-) + VC2(V^+ - V^-)^2] \times [1 + TC1 \times (10) \times (T - T_0) + TC2 \times (T - T_0)^2],$

где V⁺, V⁻ – положительный и отрицательный потенциал выводов резистора; Т, Т₀ – текущая и номинальная температура; R₀ – сопротивление резистора при номинальной температуре и малом падении напряжения на резисторе; VC1(VC2) - коэффициент линейной (квадратичной) зависимости сопротивления от напряжения (Voltage Coefficient of Resistance); TC1(TC2) коэффициент линейной (квадратичной) зависимости сопротивления от температуры (Temperature Coefficient of Resistance). В инженерной практике для расчётов обычно применяют только коэффициенты VC1, TC1, величины которых определяют как усреднённые значения в диапазоне напряжений и температур.

Нелинейность и температурная зависимость ВАХ резисторов может оказать значительное влияние на характеристики датчиков температуры, поэтому для прецизионных изделий рекомендуется применение тонкоплёночных резисторов с малым температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Если при разработке ИС доступны только полупроводниковые резисторы, то их следует выполнять на сильнолегированных полупроводниковых слоях с минимальным ТКС, который можно оценить по графикам на рисунке 4 [14].

Так, *р*-резисторы «АБМК-1.3» характеризуются сопротивлением слоя $R_s = 560$ Ом/квадрат и глубиной залегания $X_j = 0,36$ мкм, при этом их удельное сопротивление составляет $\rho \approx R_s X_j = 0,02$ Ом • см и средняя концентрация примеси $N = 3 \times 10^{18}$ см⁻³. В диапазоне температур от 300 до 450 К для *р*-резисторов ТКС = 0,0015, а параметры модели *TC*1 = 0,0015, *TC*2 = 0.

Обычно полагают, что для полупроводникового резистора нелинейность ВАХ обусловлена распространением области пространственного заряда изолирующего *p*-*n*-перехода в токопроводящую область резистора. Этот эффект аналогичен действию затвора в полевых транзисторах с *p*-*n*-переходом, поэтому для описания нелинейности ВАХ полупроводникового резистора часто применяют комбинированную модель Шихмана-Ходжеса [14].

Резисторы современных микросхем чаще всего реализованы на сильнолегированных полупроводниковых слоях, расположенных в слаболегированных изолирующих карманах. В этом случае область пространственного заряда изолирующего *p-n*-перехода преимущественно распространяется в карман, и нелинейность ВАХ резисторов в большей степени обусловлена насыщением скорости носителей заряда в электрических полях с большой напряжённостью. На рисунках 5 и 6 приведены результаты измерений ВАХ сильнолегированных резисторов разной длины (L) и ширины (W), сформированных с помощью технологического маршрута изготовления «АБМК-1.3», а именно для области p-типа с указанными выше параметрами и поликристаллического кремния (ПКК) с $R_s = 37$ Ом/квадрат и толщиной $X_t = 0,45$ мкм.

Результаты экспериментальных исследований позволили установить, что [5]:

- коэффициент VC1 зависит от напряжения, а TC1 от температуры, поэтому для моделирования температурных датчиков необходим учёт параметров модели VC2, TC2;
- для уменьшения зависимости сопротивления сильнолегированного резистора от напряжения необходимо увеличивать его длину;
- наименьшей нелинейностью ВАХ
 в диапазоне температур обладает
 низкоомный ПКК- резистор.

Схемотехнические решения датчиков температуры

Для нахождения температуры допустимо использовать температурный коэффициент напряжения (ТКН) пробоя обратносмещённого *p-n*-перехода (см. рис. 7) [5]. Однако величина положительного ТКН лавинного пробоя (туннельный пробой с отрицательным ТКН обычно характеризуется высоким уровнем шумов), сравнимая по абсолютному значению с dV_{BE}/dT, обычно достигается при пробивном напряжении, превышающем 6 В, что приводит к нежелательному увеличению напряжения питания ИС.

Как указывалось ранее, в качестве термочувствительного элемента можно применять прямосмещённый эмиттерный переход БТ. Из соотношения (3) для БТ получим:

$$V_{\rm BE} \approx \frac{m \times k \times T}{q} \times \ln \frac{I_{\rm C}}{IS}.$$
 (11)

Если коллекторный ток БТ поддерживать постоянным и измерять зависимость $V_{RF}(T)$, то абсолютную темпера-



Рис. 7. Зависимость температурного коэффициента напряжения пробоя плоского кремниевого *p-n*-перехода от величины напряжения пробоя

туру в градусах Кельвина можно определить из соотношения:

$$T \approx \frac{q}{m \times k} \times \frac{V_{\rm BE}}{\ln \frac{I_{\rm C}}{IS}}$$
(12)

К сожалению, величина *IS* имеет значительный технологический разброс и зависит от температуры, что затрудняет точное определение последней



Рис. 8. Структурная схема температурного датчика в ИС АДМ1021



Рис. 10. Упрощённая электрическая схема температурного датчика LM135

в широком диапазоне значений. Для увеличения точности определения температуры часто используют так называемую дельта-методику, в соответствии с которой:

$$T \approx \frac{q}{m \times k} \times \frac{V_{\text{BE2}} - V_{\text{BE1}}}{\ln\left(\frac{I_{\text{C2}}}{I_{\text{C1}}} \times \frac{IS_1}{IS_2}\right)}, \quad (13)$$

где V_{BE1} – величина V_{BE} при I_{C1} , IS_1 .

Так, в некоторых температурных датчиках в качестве удалённого термочувствительного элемента используют прямосмещённый эмиттерный переход внешнего транзистора, через который попеременно задают два значения тока, отличающиеся в N раз ($I_{C1} = N \times I_{C2}$) (см. рис. 8), регистрируют V_{BE1} , V_{BE2} и с учётом (13), а также $IS_1 = IS_2 = IS$ рассчитывают температуру:

$$T \approx \frac{q}{m \times k} \times \frac{V_{\text{BE1}} - V_{\text{BE2}}}{\ln N}$$
 (14)

Как следует из (14), точность регистрации температуры в этом случае не зависит от величины *IS*, однако на погрешность измерений влияет ряд других факторов [10]:

- различное падение напряжения на полупроводниковых областях удалённого чувствительного транзистора и соединительных проводах при отличающихся коллекторных токах I_{C2}, I_{C1};
- наличие наводок, возникающих при коммутации токов I_{C2}, I_{C1} через внешний транзистор, усреднённое значение которых влияет на измеренную величину V_{BE}.

В датчиках, содержащих термочувствительный элемент и схему обработки сигнала на одном кристалле, для регистрации температуры применяют два БТ, работающих при одинаковом коллекторном токе $I_{C2} = I_{C1}$, но имеющих различные *IS* ($IS_2 = N \times IS_1$) за счёт масштабирования площадей



Рис. 9. Интегральный датчик температуры



Рис. 11. Схема включения температурного датчика LM135

эмиттерных переходов транзисторов $S_{E2} = N \times S_{E1}$ (см. рис. 9) [15]. Усилитель A на рисунке 9 через цепь отрицательной обратной связи (ООС) устанавливает коллекторный ток Q1 такой величины, что напряжение между входами усилителя A близко к нулевому значению, т.е. коллекторные потенциалы Q1 и Q2 равны. Поскольку сопротивления коллекторных резисторов транзисторов Q1 и Q2 одинаковы, то действие ООС обеспечивает равенство коллекторных токов $I_{C1} = I_{C2}$, а падение напряжения на резисторе R (V_R) и выходное напряжение схемы (V_{OUT}) составляют:

$$V_{\rm R} \approx V_{\rm BE1} - V_{\rm BE2} \approx \frac{m \times k \times T}{q} \times \ln N, \quad (15)$$

$$V_{\text{OUT}} \approx 50 \times \frac{m \times k \times T}{q} \times \ln N \approx 10 \frac{\text{MB}}{\text{K}}.$$
 (16)

Резистор, обозначенный на рисунке 9 как 100R, применяется для подстройки выходного напряжения, а резистор R1 находится вне температурного датчика. Такая схема регистрирует абсолютную температуру в градусах Кельвина; при её использовании для определения температуры в градусах Цельсия из выходного напряжения следует вычесть относительно высокий постоянный уровень, $V_{OUT}(T = 273 \text{ K}) \approx 2,711 \text{ B}.$

Рассмотренный метод формирования напряжения в соответствии с (15), прямо пропорционального абсолютной температуре (Proportional to Absolute Temperature, PTAT), используется во многих полупроводниковых датчиках, основное отличие которых заключается в различном уровне формируемого РТАТ-напряжения и коэффициентах передачи масштабирующих усилителей, согласующих выходное напряжение температурного датчика с температурной шкалой в градусах Кельвина (K), Цельсия (°С) или Фаренгейта (°F).

На рисунках 10 и 11, соответственно, приведены упрощённая электрическая схема и схема включения температурного датчика LM135, в которой:

 Q15, Q16 – термочувствительные транзисторы с различающейся в 10 раз площадью эмиттерных переходов;

- масштабирование РТАТ-напряжения *V*_{BE16} – *V*_{BE15} осуществляется резистив- ным делителем в (R7 + R8 + R10)/R8 = = 50 раз;
- R1, Q9 Q14 источник тока, питающий (*I*_{C14}) термочувствительные транзисторы и (*I*_{C9}) дифференциальный каскад усилителя ООС;
- усилитель ООС (А на рисунке 9) включает дифференциальный каскад Q7, Q8 с активной нагрузкой на «токовом зеркале» Q4, Q6 и выходной каскад с «открытым» коллектором Q1, нагрузкой которого является внешний резистор (R1 на рисунке 11).

Функционирование схемы, показанной на рисунке 10, аналогично схеме рисунка 9.

Особенностью датчика температуры LM134 (см. рис. 12 и 13) является выходной сигнал в виде тока, пропорционального абсолютной температуре с коэффициентом преобразования 0,336%/°С при 25°С. Источники тока на *p-n-p*-транзисторах Q4, Q5 устанавливают с помощью ООС (Q6, R_{SET}) одинаковый коллекторный ток термочувствительных *n-p-n*-транзисторов Q1, Q2, соотношение площадей эмиттеров



Рис. 12. Упрощённая электрическая схема температурного датчика LM134



Рис. 13. Схема включения температурного датчика LM134

которых (12/1) выбрано таким образом, что РТАТ-напряжение на резисторе R_{SET} , включённом между выводами R и V^- , составляет 64 мВ при 25°C. Так как $V_{BE6} = V_{BE5} = V_{BE4}$, то коллекторный ток



Рис. 14. Структурная схема температурного датчика LM35

Q6 точно масштабирован относительно коллекторных токов транзисторов Q4, Q5. При этом ток, протекающий через резистор R_{SET} , всегда составляет 17/18 суммарного тока потребления I_{SET} ($S_{E4} = S_{E5} = S_{E6}/16$), втекающего в вывод V^* :

$$I_{\text{SET}}(25^{\circ}\text{C}) = \frac{18}{17} \times \frac{64 \text{ MB}}{R_{\text{SET}}} = \frac{67,8 \text{ MB}}{R_{\text{SET}}}.$$
 (17)

Транзистор Q3 применён вместо диодного включения Q4 для того, чтобы значительно уменьшить влияние базовых токов *р-п-р-*транзисторов на равенство коллекторных токов Q1, Q2 и таким образом устранить зависимость РТАТ-напряжения от величины Iser. Микромощные полевые транзисторы с p-n-переходом Q7, Q8, максимальный ток стока которых составляет около 20 нА, и конденсатор С1 образуют цепь (start-up circuit), запускающую работу источников тока Q4 - Q6 при подаче напряжения между выводами И⁺ и V- за время, в течение которого потенциал базы Q3 достигнет величины около 500 мВ, т.е. за 500 мВ \times 50 п Φ /20 нА = = 1.25 мс.

На рисунке 14 приведена модернизированная схема, преимуществами которой являются [15]:

- возможность получения относительно высокого температурного изменения выходного напряжения dV_{OUT}/ dT и требуемого значения выходного напряжения при заданной температуре (например, V_{OUT} = 250 мВ при 25°C);
- простой метод калибровки;
- компенсация нелинейности (curvature compensation circuit) температурной зависимости V_{BE}(*T*).

Заметим, что в качестве усилителя A1 на рисунке 14 допустимо применять усилитель напряжения с резисторами в коллекторных цепях Q1, Q2, как показано на рисунке 9, или высококачественные повторители тока [16].



Рис. 15. Электрическая схема цепи калибровки температурного датчика LM34

Такая структурная схема с небольшими изменениями применена в температурных датчиках LM34, LM35, LM50.

Разность напряжений $V_{BE2} - V_{BE1}$ преобразуется в ток резистором R1 и создаёт РТАТ-напряжение V_{PTAT} на цепочке резисторов nR_1 , суммарное сопротивление которых обычно подстраивают на пластине (см. рис. 15) для получения необходимого температурного изменения выходного напряжения.

На неинвертирующий вход усилителя A2 поступает напряжение V_{РТАТ} -2V_{ве}, которое преобразуется усилителем А2 таким образом, чтобы согласовать уровень выходного напряжения с выбранной температурной шкалой и установить температурное изменение около 10 мВ на градус этой шкалы. Так, для схемы, показанной на рисунке 14, при температуре 25°С будут справедливы следующие величины основных параметров: $V_{\text{BE1}} = 0,581$ B; $dV_{\text{BE1}}/$ $dT = -2.1 \text{ MB/°C}; V_{BE2} - V_{BE1} = 59.2 \text{ MB};$ $n = 23,3; V_{\text{PTAT}} = 1,38$ B; $dV_{\text{PTAT}}/dT =$ = 4,63 mB/°C; dV_{IN+}/dT = 8,83 mB/°C; $V_{\text{IN+}} = 0,218 \text{ B}; V_{\text{OUT}} = 0,245 \text{ B}; dV_{\text{OUT}}/dT =$ = 9,94 мВ/°С. Более точного значения температурного изменения выходного напряжения (10 мВ/°С) можно достичь за счёт подстройки на пластине величины n (рис. 15), а требуемого выходного напряжения (0,25 В при 25°С) с помощью изменения резисторов в цепи ООС усилителя А2.

Заметим, что в соответствии с (б) величина $dV_{\rm BE}/dT$ зависит от $V_{\rm BE0}$ и имеет технологический разброс, поэтому подстройка сопротивления цепочки резисторов *n*R1, выполняемая за счёт закорачивания стабилитронов или пережигания перемычек [17] в схеме на рисунке 15, необходима для любых высокоточных датчиков температуры. Выполненный в [15] анализ позволяет утверждать, что температурное изменение выходного напряжения $dV_{\rm out}/dT$, полученное при настройке для одной температуры, будет сохраняться во всём температурном диапазоне.

Как следует из (5), *V*_{ве} нелинейно зависит от температуры, что может

привести к значительным погрешностям температурного датчика по схеме рисунка 14 из-за нелинейного изменения напряжения на неинвертирующем входе усилителя А2, обусловленного падением напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе Q1 и диоде. Для компенсации температурной нелинейности V_{BE} предназначена схема, показанная на рисунке 16.

Транзисторы Q1 и Q2 на рисунке 16 применяются для задания тока в остальных трёх транзисторах схемы. Ток через Q1 и Q2 устанавливается внешней цепью прямо пропорциональным абсолютной температуре ($I_{\text{ртат}}$), поэтому ток через Q5 и R_в также будет иметь РТАТ-зависимость при условии $R_B \ll V_{BE5}/I_{E5}$. Ток через резистор R_A определяется падением напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе Q4 и поэтому убывает с ростом температуры, а эмиттерный ток Q3, являющийся суммой тока, прямо пропорционального (I_{C5}) и обратно пропорционального (I_{RA}) температуре, не зависит от температуры, т.е. I_{C3} = const. Коллекторный ток Q4 (I_{C4}) найдём из следующих соотношений:

$$I_{C4} \approx IS_4 \times \exp\left(\frac{V_{BE4}}{m \times \varphi_{T}}\right),$$
 (18)

$$V_{\rm BE4} = V_{\rm BE1} + V_{\rm BE2} - V_{\rm BE3}.$$
 (19)

Если все БТ имеют идентичные параметры *m* и *IS*, то:

$$I_{C4} = \frac{I_{C1} \times I_{C2}}{I_{C3}} = \frac{I_{PTAT}^2}{I_{const}}.$$
 (20)

Таким образом, генерируется ток *I*_{C4}, прямо пропорциональный квадрату температуры и компенсирующий температурную нелинейность двух последовательно соединённых прямосмещённых *p*-*n*-переходов.

На погрешность температурных датчиков могут оказывать влияния ТКС резисторов, а также обратные токи коллекторных переходов и переходов коллектор – подложка термочувствительных транзисторов (Q1 и Q2 на рис. 14). Хотя обратные токи довольно малы, их величина обычно удваивается при увеличении температуры на 10°С, что может привести к дополнительной температурной нелинейности V_{ве}. Для выравнивания обратных токов транзисторы Q1 и Q2 целесообразно формировать из матрицы транзисторов, часть из которых соединена со схемой (см. рис. 17) [15], а топология транзисторов должна обеспечивать максимальную идентичность их параметров [14]. Дополнительным фактором, повышающим точность температурных датчиков, является использование тонкоплёночных резисторов с малым ТКС и отсутствием зависимости сопротивления от напряжения.

Основные параметры распространённых датчиков температуры приведены в таблице.

Выводы

регистрации температуры Лля в биполярных полупроводниковых датчиках чаще всего применяют температурную зависимость падения напряжения на прямосмещённом эмиттерном переходе (соотношение (5)) и формирование напряжения, прямо пропорционального абсолютной температуре (РТАТ-напряжения) по соотношению (15). РТАТ-напряжение в КМОП-датчиках получают как разность падения напряжения на двух р-п-переходах разной площади, через которые протекает одинаковый ток; коммутацией разных токов через один *p-n*-переход, как показано на рисунке 8, или с помощью КМОП-транзисторов, работающих в области слабой инверсии, в которой зависимость тока стока от напряжения затвор-исток $I_{\rm D} = f(V_{\rm GS},T)$ аналогична $I_{\rm C} = f(V_{\rm BE}, T)$.

Прецизионные датчики температуры целесообразно создавать на термочувствительных биполярных транзисторах с отличающейся в 10–15 раз площадью эмиттерных переходов и компенсацией нелинейной зависимости $V_{\rm BE} = f(T)$. Такие датчики возможно реализовать не только по биполярной, но и по КМОП-технологии с применением стандартных структур.

Литература

- Дворников О.В., Чеховский В.А., Дятлов В.Л., Прокопенко Н.Н. Особенности аналоговых интерфейсов датчиков. Современная электроника. № 2. № 3. 2013.
- Baker B. Temperature Sensing Technologies. Microchip Technology Inc. AN679.

- Lepkowski J. Temperature Measurement Circuits for Embedded Applications. Microchip Technology Inc. AN929.
- Дворников О.В., Чеховский В.А., Дятлов В.Л., Прокопенко Н.Н. Интерфейсы датчиков для систем на кристалле. Современная электроника. № 8. 2013.
- Прокопенко Н.Н., Дворников О.В., Крутчинский С.Г. Элементная база радиационностойких информационно-измерительных систем. Шахты. 2011.
- 6. *Достал И*. Операционные усилители. Мир. 1982.
- Сергеев В.С., Кузнецов ОЛ., Захаров Н.П., Летягин В.А. Напряжения и деформации в элементах микросхем. Радио и связь. 1987.
- Meijer G.C.M., Wang G., Fruett F. Temperature sensors and voltage references implemented in CMOS technology. IEEE Sensors Journal. Vol. 1. № 3. 2001.
- 9. Digital temperature sensor accuracy explained. Philips. AN10349.
- 10. *Jones M*. Accurate temperature sensing with an external P-N junction. www.edn.com.
- Дворников О.В., Шульгевич Ю.Ф., Толкун А.В. Применение постпроцессора PROBE для анализа результатов измерителя параметров полупроводниковых приборов ИППП-1. www.mnipi.by.
- 12. www.mnipi.com.
- 13. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы. Мир. 1988.
- Абрамов И.И., Дворников О.В. Проектирование аналоговых микросхем для прецизионных измерительных систем. Минск. 2006.
- LM34/LM35 Precision Monolithic Temperature Sensors. Texas Instruments. AN-460.



Параметры распространённых ИС датчиков температуры



Рис. 16. Электрическая схема цепи компенсации температурной нелинейности LM34



Рис. 17. Электрическая схема цепи термочувствительных транзисторов LM34

- Дворников О.В. Схемотехника биполярно-полевых аналоговых микросхем.
 Часть 2. Высокоточные повторители тока. Chip News. № 10. 2004.
- Дворников О.В. Применение элементов с изменяемым сопротивлением для подгонки характеристик монолитных ИС. 2001.